

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/004216 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 21/301, 21/52, C09J 7/02 (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009629

(22) 国際出願日: 2004年7月7日 (07.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-271950 2003年7月8日 (08.07.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町23番23号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 佐伯尚哉 (SAIKI, Naoya) [JP/JP]; 〒3430806 埼玉県越谷市宮本町1-148-1-203 Saitama (JP).

(74) 代理人: 鈴木俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目13番6号 五反田山崎ビル6階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: HARDENABLE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE SHEET FOR DICING/DIE-BONDING AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: ダイシング・ダイボンド用粘接着シートおよび半導体装置の製造方法

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a hardenable pressure sensitive adhesive sheet for dicing/die-bonding, which is free from the generation of voids between a hardenable pressure sensitive adhesive layer and a die pad portion even when a chip is placed on a die pad portion having great undulation and thus is excellent in embedment characteristics. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A hardenable pressure sensitive adhesive sheet for dicing/die-bonding, characterized in that it comprises a substrate and, provided thereon, a hardenable pressure sensitive adhesive layer which exhibits a ratio (M_{100}/M_{50}) of the modulus of elasticity at 100°C (M_{100}) to the modulus of elasticity at 50°C (M_{50}) of 0.5 or less.

(57) 要約: [解決課題] 高低差の大きなダイパッド部にチップを搭載した場合でも、ダイパッド部と粘接着剤層との間にボイドが発生することない、埋め込み性に優れた粘接着剤層を有するダイシング・ダイボンド用粘接着シートを提供することを目的としている。 [解決手段] 本発明に係るダイシング・ダイボンド用粘接着シートは、100°Cでの弾性率 (M_{100}) と70°Cでの弾性率 (M_{70}) との比 (M_{100}/M_{70}) が0.5以下である粘接着剤層が基材上に設けられてなることを特徴としている。

WO 2005/004216 A1